

両面フル3D 3D AOI基板両面同時検査装置 EAGLE 3D 8800TWIN



製品概要

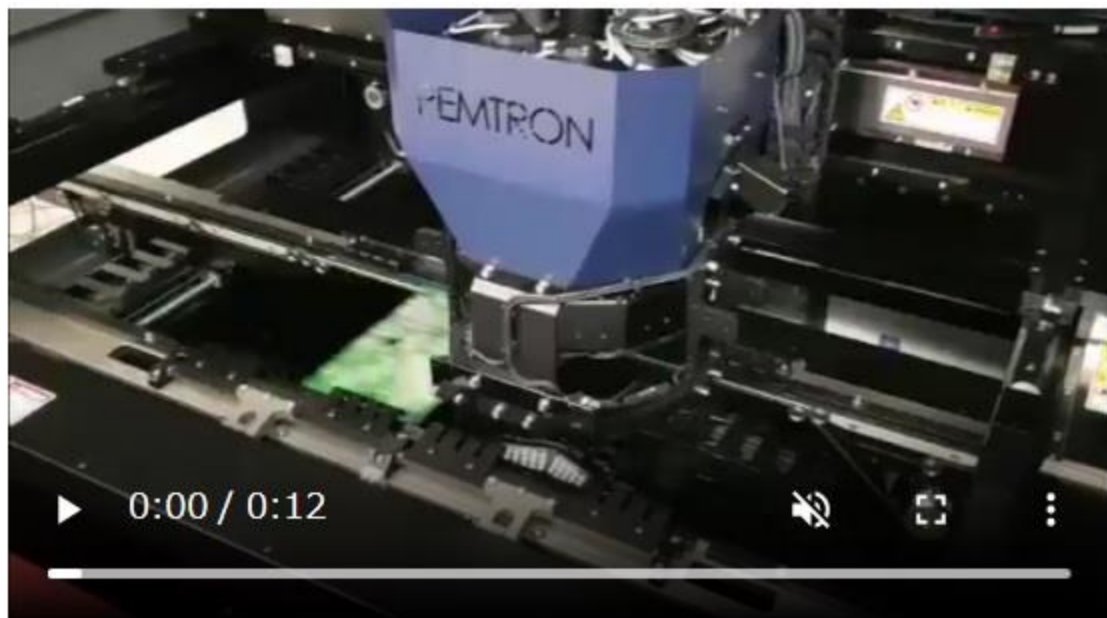
- 両面フル3D AOI 基板両面同時検査装置登場
- トップ/ボトム両面同時検査
- 従来製品と比較して圧倒的にタイムロスを低減
- フルパフォーマンス・フルスピード検査が可能
- マルチコンフィグ採用
- 簡単インターフェースでユーザーフレンドリー
- 是非、現在ご使用の設備と比較して下さい

新設計ボトムヘッドカメラ採用

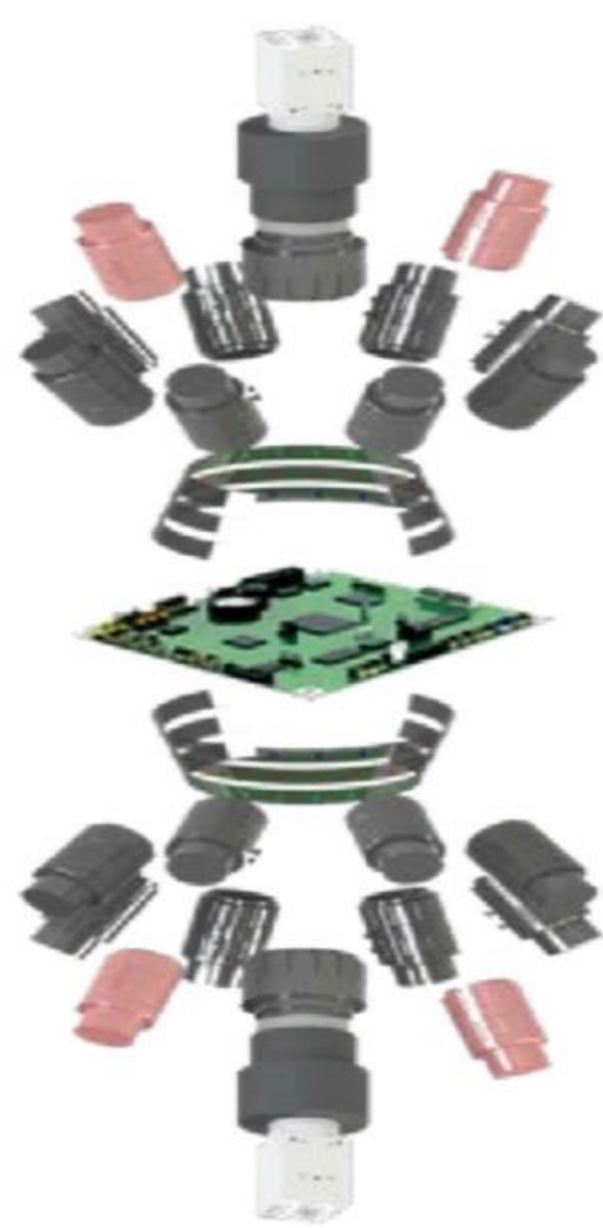
ペントロンの8800TWIN 3D AOIは、基板両面同時検査に対応する為にトップカメラとボトムヘッドカメラを搭載した装置です。

駆動軸は、コンベアの移動無しにX/Y方向で、カメラヘッドのみ移動させます。

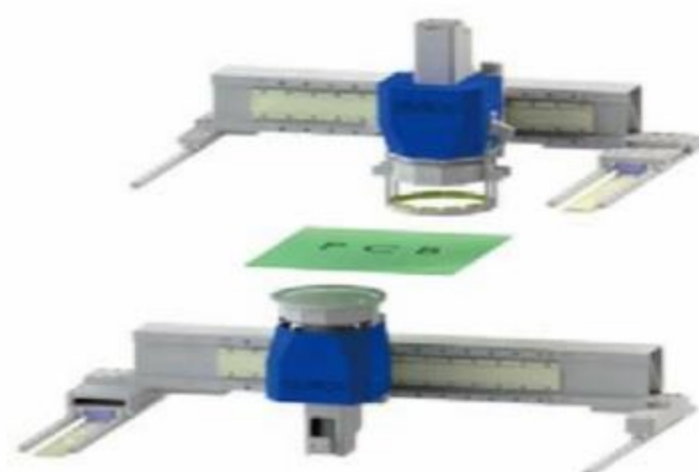
この機能より、非常に高速かつ精密で安定的な検査プラットフォームを提供しています。



特長



8方向/10方向プロジェクション+3段RGB-LED照明



トップ&ボトム両面の駆動方式 XYリニアモータ

- ・フル3Dでのスピードと測定技術の融合
 - 8方向/10方向プロジェクション+3段RGB-LED照明
 - 3D両面同時検査アルゴリズム
 - テレセントリックレンズ搭載で歪みの無い画像
- ・レーン&効率的なフルラインコントロール
- ・世界最高レベルと評価された3Dイメージ表現力
- ・ユニークな3Dインペーション&フレキシブルソリューション
- ・最高の3D技術を簡単操作でオペレーション
- ・4方向サイドカメラ (オプション)
 - ダイレクトで簡単にコネクタ奥側の検査領域を作成
 - 従来の検査データに容易に追加可能なアルゴリズム
- ・シンプル&直感的なインターフェース
 - 従来のUIを継承し、AOI装置共通の簡単操作が可能
 - 検査結果を同時に表示可能
- ・トップ/ボトム同時にAOIとDIP検査が可能

正確なエラー判定とクリアな画像

- 最高の3Dイメージが実現する“最高の検出能力”
- 1μmの解像度での高さ検出
- いつもクリアで最高の精度
- コンポーネントサイズX、Y入力無制限
- シームレス&高速画像取得



仕様

型 式		EAGLE 3D-8800TWIN			EAGLE 3D-8800TWIN PRO
カメラ		10MP			12MP
解像度		10μm	15μm	18μm	15μm
検査スピード		19.2cm ² /sec	43.2cm ² /sec	61.5cm ² /sec	52.65cm ² /sec
FOV (Field of View)		32x20mm	48x45mm	57x54mm	450x60mm
検査の種類		Polarity (THT,SMD) ,Offset,Angle, Solder Joint (SMD,THT,ICS) ,Short circuit (Solder bridges) ,Solder Paste Inspection			
許容高さ		0-5.5mm (オプション 27mm)			
高さ測定誤差		±3%			
Max. PCB 反り許容		±3mm			
モータータイプ		XYリニアモーター			
PCBスペック	検査サイズ	Min.50 x 50mm (2 x 2 inch) Max.510x510mm (20x20 inch)			
	搬送可能基板厚	0.4-7.0mm			
	基板上面クリアランス	50mm			
	基板下面クリアランス	50mm			
入力電源		200-240VAC, 1Phase, 50/60Hz			
消費電力		5.9KW/27Amp			
外形寸法 (WxDxH / W eight)	標準	1660 x 2500 x 1990mm		約 1650kg	